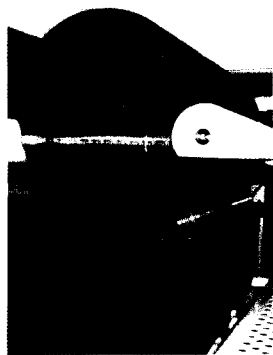


湿法处理系统 ▶

CenTurio 是一套高效湿法工艺系统，并配备有 CenTurioDry 干法工具和极其有效的清洗系统。该系统可用于大部分衬底材料的一般刻蚀和/或清洁工艺。

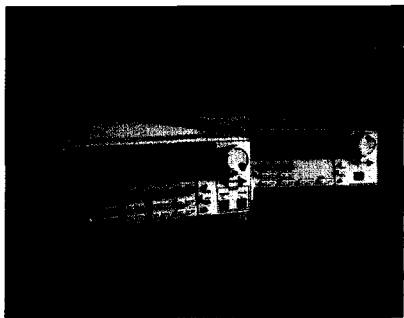
AP&S International GmbH

www.ap-s.de



低电流测量数字源表 ▶

2600 系列 SourceMeter® 数字源表的两款新产品 2635 和 2636，采用最新特殊参数分析技术，实现了高达 1fa (10-15 安) 的测量分辨率，从而满足了很多半导体、光电和纳米器件的测试需求。其基于仪器的多通道架构相比普通的基于主机的源测量方案降低了 50% 的成本。2636 和 2635 具有廉价的扩展性和更短的测试时间。通过其测试脚本处理器 (TSP®) 和 TSP-Link® 互连通信总线，测试工程师可利用 2636 和 2635 快速构建用于技术研究、特征分析、圆片分拣、可靠性测试、生产监测等多种测试应用场合的高速测试系统。



吉时利仪器公司

www.keithley.com

System 650 万能黏结测试仪

System 650 的快速启动测试模块支持引线测试、引镊测试、球形粘合剪切测试、低温拉球测试或芯片剪力强度测试之间的快速转换。所有的转换测试模块可有广大范围的选择，容许待测力精度低于 1 公丝。不同机器之间的校准精确度在总系统内保持 0.15% 的精确度。标准控制 PC 被整合进该系统中。

测试仪高分辨率的运动控制系统可以重复提供小于 1 微米的粘合剪切厚度，可以剪切重达 200 Kg (440 lbf) 的较大的裸片。305 mm x 155 mm 的随动装置驱动型 XY 镜台可测试 300mm 的晶圆、引线架、较大的基片或 PC 板。

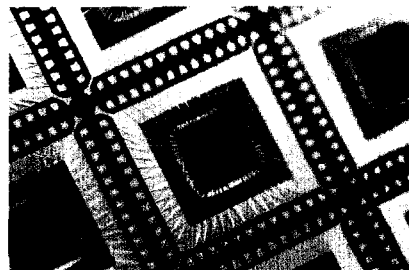
Bond Test Manager™ 控制程序在 Windows® XP 下运行，整个系统的体积为长 560 mm (22in) x 宽 432 mm (17in) x 高 585 mm (23in)。

Royce Instruments

www.royceinstruments.com

芯片粘结浆料 ▶

QMI708 是一款高性能芯片粘结浆料，主要针对铜框架上的小尺寸芯片设计。该材料用于在采用铜引线框架的 QFN 和 SOIC 封装，可粘结 2.5 × 2.5 mm 或更小的芯片。该浆料可以快速分散而没有拖尾现象；较低的键合连接阻抗，降低了能量排放。

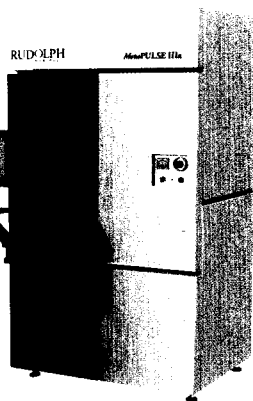


Henkel

www.henkel.com/electronics

DRAM 度量系统 ▶

MetaPULSE IIIa 是一款薄膜度量工具，主要用于基于氧化铝 DRAM 制造工艺，用于薄膜厚度的测量。PULSE 技术可以提供大规模、在产品上进行的厚度测量，以及多种类型、尺寸和多层结构的金属薄膜表征。由于采用了更高放大倍数的光学系统，缩小了光斑尺寸，并且提高了兼容性，该系统的吞吐率可以提升 25%。



Rudolph Technologies Inc.,

www.rudolphtech.com

PECVD 系统 ▼

Vector Extreme 是一款 PECVD 工具，其生产率达 250 wph。该工具可以集成多达三个顺序工艺操作模块，在一个中心晶圆处理腔的基础上可以实现 12 个沉积台。如果采用这样的设置沉积用于存储器器件较厚的薄膜，其吞吐率可加倍。



Novellus Systems Inc.

www.novellus.com